

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表

证券简称：联得装备

证券代码：300545

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	方正证券、天风证券、中银证券、富荣基金、纽富斯投资、长安汇通、华福证券、东北证券等 11 位机构投资者
时间	2024 年 5 月 30 日
地点	东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：刘雨晴女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司概况</p> <p>简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。</p> <p>二、投资者会议问答交流</p> <p>Q1：公司有哪些竞争优势？</p> <p>A1：公司主要从事新型半导体显示智能装备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备、锂电装备的研发、生产、销售及服务。公司深耕半导体显示设备行业二十余年，经历了显示产业的多种技术变革，通过多年的技术沉淀和积累实现了半导体显示产业各种技术之间的掌握和融合，具备了良好的产品研发设计能力和制造工艺水平，使公司的产品研发设计能力、产品质量性能均处于行业前列。公司凭借优异的产品质量和多年来积累的核心技术优势，以及全方位的、高质量的售前、售中、售后个性化、定制化服务，公司在业内树立了良好的口碑，公司已经拥有一批具有长期稳定合作关系的客户，与包括大陆汽车电子、博世、京东方、维信诺、深天马、</p>

德赛西威、华星光电、苹果、华为、富士康、夏普、业成、蓝思科技、惠科等知名企业建立了良好的紧密的合作关系。公司凭借行业经验优势、研发创新优势、品牌优势、综合服务优势、客户资源优势，实现了公司经营规模及业绩的稳定增长。

Q2: 在 Mini/Micro LED 领域，公司有研发哪些设备？

A2: 继 OLED 显示技术后，Mini/Micro LED 是近年来新兴的下一代显示技术，目前正处于快速发展的阶段，预计未来几年会保持高速增长。公司目前在 Mini/Micro LED 领域，已经推出芯片分选设备、芯片扩晶设备、检测设备、真空贴膜设备、芯片巨量转移设备、高精度拼接设备等。

Q3: 公司在半导体领域发展如何？

A3: 公司积极布局半导体领域，已经凭借研发成功的半导体 IC 封装设备顺利切入半导体封测行业。目前共晶、软焊料等固晶机和 QFN 引线框架贴膜、引线框架检测等设备已经交付客户量产。历经多年技术积累和业务发展，公司在半导体领域开发了一批国内知名公司为核心客户群体，公司将密切关注行业发展动态和前沿技术的发展趋势，积极创造并把握半导体设备领域的发展机遇。

Q4: 公司在海外市场拓展情况如何？

A4: 公司在海外市场积累了如大陆汽车电子、博世、伟世通等诸多世界 500 强的客户资源，并建立了良好的合作关系。汽车智能化的发展促使汽车智能座舱系统在整车中扮演越来越重要的角色，带来汽车智能座舱系统相关设备的需求不断壮大，公司在该行业的布局逐渐在订单中变现，特别是公司与国外大客户的深度合作，实现了设备在欧洲、东南亚、北美的落地。

Q5: 公司研发技术人员有多少，研发费用占比多少？

A5: 公司是一家注重技术研发与创新的国家级高新技术企业，致力于依靠自主创新实现企业可持续发展。为提升产品竞争力，公司不断加大研发投入，加强自主创新及新产品研发。截至 2023 年 12 月 31 日，公司研发支出 12,093.95 万元，占营业收入 10.02%。为保持公司研发创新优势，公司持续增加研发技术人才的储备。公司拥有研发及技术人员 835 人，占公司总体员工数量的 48.26%。在公司持续加大研发投入、引进优秀技术人才

	<p>的推动下，公司产品制造水平、研发创新能力一直居于国内同行业的前列。</p> <p>Q6: 请简单介绍一下公司的生产模式?</p> <p>A6: 公司的设备生产实行“以销定产”的生产模式。公司的产品具有较为鲜明的定制化特点，产品生产需根据客户不同的设计方案、材料选择、性能、规格等进行定制化生产。</p> <p>Q7: 公司未来有何规划?</p> <p>A7: 公司将持续加强在半导体显示模组设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备及新能源装备领域的研发。积极开拓柔性显示模组设备及显示前端工序贴合类设备、Mini/Micro LED 设备、VR/AR/MR 精密组装设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备以及新能源装备在新兴领域的应用市场，同时继续加大这些领域的新技术、新产品研发力度，支撑该业务快速成长。公司将通过多维度的产品布局，丰富产品种类，完善产品体系，通过内延发展孵化研发技术团队模式，形成稳健持续的发展平台。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024-5-30